

	製造商	廠牌	產地
A(MIT)	本國	本國	本國
B(MIT)	本國	本國	本國OR 大陸以外
C(非紅)	本國OR 大陸以外	本國OR 大陸以外	本國OR 大陸以外
D(不完全 非紅)	本國OR 大陸以外	本國OR 大陸以外	不限
E(未非紅)	不限	不限	不限

第一層	整機(A)					
第二層 (模組)	飛行載具 模組	動力 模組	飛導控 模組(C)	通訊 模組(C)	地面導控 模組(A)	酬載 模組(A)
	機身結構(A)	螺槳(A)	飛控晶片(C)	通訊晶片(C)	導控電腦(A)	雲台(C)
	機身外殼(A)	電池(C)	飛控軟體(C)	GPS晶片(C)	遙控器(A)	光學鏡頭(C)
		ESC(C)		天線(A)		熱像儀(C)
		馬達(A)		數圖傳(C)		雷射測距(C)
		引擎(C)				
第三層 (零件)	主動元件(具運算、儲存功能之晶片、記憶體):(C) 被動元件(含光學鏡):(D*)					

\*設緩衝期

### 無人機全機系統整合

